

略)

10月30日(金) 12:35-14:50

セッションチエアマン： 山本 浩之(マイクロンメモリ ジャパン(株))・三富士 道彦(ローム(株))

### ◆ 先端ロジック半導体デバイスの技術動向



東京大学  
工学系研究科  
生産技術研究所  
教授  
小林 正治

#### [講演要旨]

AI 技術の発展にともない計算機能力の向上が増々求められている。計算機能力の向上には半導体のさらなる高集積化が必要であり、ロジック半導体デバイスの微細化が欠かせない。本講演では先端ロジック半導体デバイスの技術動向を解説し、今後のデバイス・プロセス技術の方向性について議論する。

#### [講演者プロフィール]

2010年1月、米国スタンフォード大学 Ph.D 修了。同年2月米国 IBM ワトソン研究所に入所。14nm SOI CMOS の開発および 10nm 世代以降の先端 CMOS のパスファインディングに従事。2014年5月より東京大学生産技術研究所に准教授として着任。2019年10月より同学工学系研究科附属デザインシステム研究センター(d.lab)に所属。2025年8月より東京大学生産技術研究所教授。現在、高エネルギー効率コンピューティングに向けたトランジスタおよびメモリ技術の研究を行っている。2022年より Rapidus 株式会社顧問。

### ◆ エンドポイント AI チップ”Solist-AITM”による機械設備等の異常の予兆検知(仮題)



ローム株式会社  
LSI 開発本部  
回路技術開発部  
技術主幹  
浜地 健次

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

---

◆ 低電圧化により縦方向スケーリングが可能な 3D 強誘電体 NAND(FeNAND)メモリ(仮題)



マイクロメモリジャパン株式会社  
FELLOW-NAND PATHFINDING  
合田 晃

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

---

※本講演に興味を持たれた方は、こちらの講演もご覧になっています。

【C-1】 AI 時代の勝者を探る

【C-3】 装置・プロセス・実装技術が AI 最前線を支える